

平成 25 年 6 月 7 日

各 位

会社名 シャープ株式会社  
代表者名 取締役社長 奥田隆司  
(コード番号 6753)

**Qualcomm に対する第 2 次第三者割当に係る  
発行条件等の確定及び新株式の発行に関するお知らせ**

当社と Qualcomm Incorporated (以下「Qualcomm」といいます。) の 100%出資子会社である Pixtronix, Inc. (以下「Pixtronix」といいます。) との間の次世代の MEMS (Micro Electro Mechanical System: 微小電子機械システム) ディスプレイの共同開発を目的とする業務提携に関する平成 24 年 12 月 4 日付の共同開発契約 (以下「共同開発契約」といいます。) 及び Qualcomm との間の第三者割当増資に関する平成 24 年 12 月 4 日付の出資引受契約 (以下「出資契約」といいます。共同開発契約とあわせて、以下「共同開発・出資契約」といいます。) に基づき、2 回に分けて行うこととしていた Qualcomm を割当先とする第三者割当による新株式の発行のうち、今般、第 2 次分 (以下「第 2 次第三者割当増資」といいます。) に関して、増資実行の条件が充足したため、平成 25 年 6 月 7 日開催の当社取締役会 (以下「本取締役会」といいます。) において、第 2 次第三者割当増資について、払込期日を平成 25 年 6 月 24 日とし、また、その発行価額、発行株式数及びその他の条件を決定する発行決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。Qualcomm を割当先とする第三者割当による新株式の発行のうち、第 2 次第三者割当増資に関して、払込期日の予定日を平成 25 年 6 月 28 日とすることを平成 25 年 3 月 22 日のプレスリリースにおいてお知らせしておりましたが、今回発行条件等が確定したものです。

なお、共同開発・出資契約に基づく Qualcomm を割当先とする第三者割当による新株式の発行のうち、平成 24 年 12 月 27 日を払込期日としていた第 1 次分 (以下「第 1 次第三者割当増資」といいます。) に関しては、平成 24 年 12 月 27 日のプレスリリースでお知らせしましたとおり、同日をもって払込み及び新株式の発行を完了しております。

記

1. 募集の概要

当社は、平成 24 年 12 月 4 日のプレスリリース (平成 24 年 12 月 6 日の訂正プレスリリースによる訂正を含め、以下「平成 24 年 12 月 4 日プレスリリース」といいます。) でお知らせしましたとおり、Qualcomm の 100%出資子会社の Pixtronix が保有する MEMS ディスプレイ技術と当社が保有する IGZO-TFT 技術の統合により、次世代の MEMS ディスプレイ (以下「次世代 MEMS ディスプレイ」といいます。) の実用化技術の共同開発を行い将来における実用化に向け取り組むことを目的とする共同開発契約を Pixtronix と締結し、また、共同開発契約による提携を確実に推進するため、Qualcomm と出資契約を締結しました。

共同開発・出資契約では、次世代 MEMS ディスプレイの共同開発及び実用化技術の研究開発は、二段階で行うものとしています。すなわち、第一段階として、当社は当該次世代 MEMS ディスプレイの開発に関する研究開発及び設備投資を行い、第一段階における実用化技術の開発において、一定の条件 (ディスプレイモジュールの製品仕様の確立、設備の導入に関する計画作成及びその他研究開発に必要な資源・体制の確保等の諸条件が完了していることを両社で確認すること、並びに当社が連結ベースで平成 24 年度下期営業黒字化を実現すること、平成 25 年 3 月 31 日付で純資産 1,000 億円及び現預金 1,250 億円を有すること (あるいは平成 25 年 3 月 31 日前に払込みが行われる場合には数値が達成される見込みがあること) が充たされていること。 (以下「本追加投資主要条件」といいます。)) が充足した時点で、有価証券届出書に係る訂正届出書 (以下「本訂正届出書」といいます。) を提出し、払込期日までに同届出書の効力が生じること (以下「本追加投資条件」といいます。) を条件に第三者割当増資を実施し、実用化技術開発の第二段階に移行することとしております。

かかる共同開発の第二段階に進むための追加資金を調達する目的で、平成24年12月4日の当社取締役会では、平成24年12月4日プレスリリースでお知らせしましたとおり、平成25年3月29日を払込期日とした第三者割当増資（以下「旧第2次第三者割当増資」といいます。）を決議し、旧第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書を提出しておりました。その後、両社による共同研究を進めた結果、平成25年3月22日において、当該時点では両社間で条件充足の確認に向けての協議が完了しておらず、本追加投資主要条件の充足の確認に関して、精度及び確実性の高い情報及び状況を前提に慎重に判断するために暫くの時間の猶予が必要であるとの両社認識に至ったことを踏まえて、旧第2次第三者割当増資を一旦取り止めることとし、当該有価証券届出書を同日に取り下げました。

共同開発・出資契約においては、平成25年3月29日までに本追加投資主要条件の充足が困難な場合には、第二段階の共同開発に移ることにつき3か月の猶予を設け、平成25年6月30日まで延長するとしていたことから、かかる規定に基づき、両社で協議した結果、共同開発・出資契約における共同開発の第二段階の追加資金に充てる手段として、旧第2次第三者割当増資に代えて、平成25年3月22日開催の当社取締役会で、払込期日の予定日を平成25年6月28日として設定し、その他の条件は旧第2次第三者割当増資と同じである第2次第三者割当増資を行うことを決定し、有価証券届出書を提出しておりました。

また、第2次第三者割当増資に関しては、払込期日の予定日を平成25年6月28日としていましたが、それより前に本追加投資主要条件が充足する場合には、共同開発・出資契約に基づき、可及的速やかに本訂正届出書を提出し、平成25年6月28日よりも前の日を払込期日とし、第2次第三者割当増資を実行することとしていました。

今般、Qualcommとの間で、本追加投資主要条件の充足が確認されたため、次世代MEMSディスプレイの共同開発及び実用化技術の研究開発の第二段階に移行するために、平成25年6月24日を払込期日として第2次第三者割当増資を実施することを決議し、その諸条件に関して、本取締役会で決定したものです。

#### 第2次第三者割当増資

① 払込期日	平成25年6月24日（月）
② 発行新株式数	11,868,000株
③ 発行価額	1株につき502円
④ 調達資金の額	5,957,736,000円
⑤ 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法によります。 (Qualcomm Incorporated 11,868,000株)
⑥ その他	※金融商品取引法に基づく第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書及び本訂正届出書の効力発生を条件とします。

- (注) 1. 払込期日については、平成25年3月22日開催の当社取締役会時点では、本追加投資主要条件の充足に関しては両社で協議が完了しておらず、本追加投資主要条件の充足につき両社で合理的に満足できる形で確認できる時点に関しては、当該時点では一義的に決められなかったため、両社での協議を踏まえて、共同開発・出資契約において第二段階の共同開発に移ることにつき3か月の猶予期間である平成25年6月30日までににおける最終日（ただし払込受領との関係で金融機関休業日である平成25年6月29日及び30日を除きます。）である平成25年6月28日を払込期日の予定日としていましたが、当該日前であっても、本追加投資主要条件の充足が確認出来次第、共同開発・出資契約に基づき、可及的速やかに本訂正届出書を提出し、本訂正届出書の効力が発生次第速やかに第2次第三者割当増資を実施することとしていました。今般、両社で、本追加投資主要条件の充足が確認されたことから、本取締役会において第2次第三者割当増資に係る発行価格及び発行数等と共に、払込期日に関して、平成25年6月24日として決定したものです。なお、第2次第三者割当増資は、払込期日である平成25年6月24日において、本訂正届出書が効力を生じていることその他本追加投資条件の充足が維持されていることを条件に実行されます。
2. 第2次第三者割当増資により発行する株式に関し、平成25年6月25日開催予定の当社定時株主総会に係る議決権の付与はいたしません。

なお、平成24年12月27日に払込みが完了している第1次第三者割当増資の概要につきましては、後記「10.(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況」をご参照ください。

## 2. 募集の目的及び理由

中小型液晶事業のターゲットであるスマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器の市場は、その拡大が進むにつれ、搭載するディスプレイにも更なる視認性の高さや低消費電力化が求められることが見込まれています。そこで、当社は、平成 24 年 12 月 4 日プレスリリースでお知らせしましたとおり、当社が保有する IGZO-TFT 技術と Pixtronix が保有する MEMS ディスプレイ技術を持ち寄り、更なる画質の向上と低消費電力を実現するモバイル機器向け次世代 MEMS ディスプレイの共同開発を目的とした共同開発・出資契約を締結しております。

当社は、これにより MEMS ディスプレイが優位性を持つと考える色再現性に加え、IGZO-TFT 技術の特長である高速応答と低消費電力を生かすことによって、世界初になると考えられる MEMS ディスプレイの開発と実用化を効率的に実現することが可能となり、技術開発競争と価格競争が厳しい経営環境においても、品質の向上を確保することで安定的な収益確保については当社の企業価値の向上に結び付けられる、と考えております。

このように、Pixtronix の MEMS ディスプレイ技術はかかるモバイル機器向け次世代 MEMS ディスプレイの共同開発のため不可欠な技術と考えており、同社と共同開発契約を締結し、パートナーとすることは両社にとって大きなメリットをもたらすものとの結論に達したものです。また、これに伴い、Pixtronix との共同開発契約による提携を確実に推進するため、同社の親会社である Qualcomm を割当予定先とした 2 段階による第三者割当増資を実施することを決定したものです。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額

① 払込金額の総額	5,957,736,000 円
② 発行諸費用の概算額	105,000,000 円
③ 差引手取概算額	5,852,736,000 円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用に内訳は、登記費用 (約 21 百万円)、弁護士及び財務アドバイザー費用 (約 55 百万円)、取引所上場関係費用 (約 9 百万円) 及びその他 (約 20 百万円) です。

### (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

上記差引手取概算額の具体的な使途については、次のとおり予定しております。また、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

具体的な使途	金額	支出予定時期
次世代 MEMS ディスプレイ生産技術開発経費	1,200 百万円	平成 25 年 6 月～ 平成 26 年 12 月
次世代 MEMS ディスプレイ生産技術開発用設備投資	4,653 百万円	平成 25 年 6 月～ 平成 26 年 12 月

(注) 当社は、次世代 MEMS ディスプレイの実用化の技術開発に目処が立ったことから、次世代 MEMS ディスプレイの実用化に必要な生産ラインその他必要な生産設備を設置することを予定しており、上記の手取金はそのために必要な設備投資に充当する予定です。

当社は、事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を推進しており、その具体的な施策として、当該分野における技術やプロダクトの競争力強化並びに製造・生産等の事業効率の向上を企図した継続的な設備投資等を今後予定しております。

その一環として、モバイル機器向け液晶製造プロセスの内製化を目的とする製造設備の合理化、及び液晶ディスプレイの画素密度の高精細化のための新規技術導入に係る投資等を計画しており、当該計画の実行に際して必要な資金を調達するため、平成 24 年 3 月 27 日にお知らせした鴻海精密工業股份有限公司等を割当予定先とする第三者割当増資 (以下「平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資」といいます。) 及び平成 25 年 3 月 6 日にお知らせした SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. の日本法人であるサムスン電子ジャパン株式会社 (以下「サムスン電子ジャパン」といいます。) を割当予定先とする第三者割当増資 (以下「平成 25 年 3 月 6 日決議第三者割当増資」といいます。) を決議しました。なお、平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資に関しては、

払込期日であった平成 25 年 3 月 26 日までに払込みが行われなかったことから、実施されませんでした。平成 25 年 3 月 6 日決議第三者割当増資に関しては、平成 25 年 3 月 28 日に払込みが行われ、実施されました。

一方、第 1 次第三者割当増資及び第 2 次第三者割当増資は、次世代 MEMS ディスプレイパネル技術・実用化技術の確立のための開発投資等を計画しており、当該計画の実行に際して必要な資金を調達することを目的としているため、これらは、平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資及び平成 25 年 3 月 6 日決議第三者割当増資とは異なる資金使途に基づいて行われるものです。

以上のとおり、第 2 次第三者割当増資は当社の資本政策に資するものですが、平成 24 年 3 月 27 日決議第三者割当増資または平成 25 年 3 月 6 日決議第三者割当増資に代わる資本政策として位置づけたものではありません。

#### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器の市場拡大が進むにつれ、搭載するディスプレイにも更なる視認性の高さや低消費電力化が求められています。MEMS ディスプレイの特長である高い色再現性に IGZO-TFT 技術の特長である高速応答かつ低消費電力などを生かした次世代の高付加価値ディスプレイを開発することは、当社が今後成長を持続するために不可欠であり、当社グループの中長期的な企業価値及び株主利益の向上に寄与すると見込まれるため、そのための研究開発及び設備投資費用である当該資金使途には合理性があるものと判断しております。

#### 5. 発行条件等の合理性

##### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

第 2 次第三者割当増資の払込金額につきましては、平成 25 年 3 月 22 日開催の当社取締役会において、追加投資主要条件充足日の 2 営業日前の日から遡った 20 営業日の間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1 円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。）とすることに決定していたことを受けて、本取締役会において、追加投資主要条件充足日である平成 25 年 6 月 7 日の 2 営業日前の日から遡った 20 営業日の間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1 円未満の端数はこれを切り上げます。）である 502 円に決定いたしました。

追加投資主要条件充足日の 2 営業日前の日から遡った 20 営業日の間の終値の単純平均値を参考としたのは、第 2 次第三者割当増資に係る払込期日が一定期間先の将来の日となっていることを考慮すると、適正な払込金額水準に関しては前もって決定することが適切ではない面もあり、第 2 次第三者割当増資の払込金額についてその発行直前の比較的短期間の株価水準を参考にしたほうがよいと考えたためです。また、当社の株価は、ここ 1 年ほどの間、昨今の業績不振や通期計画の下方修正を受けてそれ以前の市場価格と比べて大幅に下落した水準となった時期もある等、現状の株価は変動が大きかったことに鑑みると、特定の日における価格のみを参考にするよりも、価格決定時の直近の比較的短期間の平均値を参考とすることの方が妥当と判断したためです。

なお、かかる払込金額 502 円は、第 2 次第三者割当増資の発行価格を含め諸条件を決定した本取締役会決議日の直前営業日である平成 25 年 6 月 6 日の当社株式の終値 401 円に対しては 25.19%のプレミアム、直前営業日から 1 か月遡った期間の終値の単純平均値 485 円(小数点以下は四捨五入)に対しては 3.51%のプレミアム、直前営業日から 3 か月遡った期間の終値の単純平均値 375 円(小数点以下は四捨五入)に対しては 33.87%のプレミアム、直前営業日から 6 か月遡った期間の終値の単純平均値 342 円(小数点以下は四捨五入)に対しては 46.78%のプレミアムを行った金額となります。また、本払込金額は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠しております。

当社といたしましては、本払込金額は合理的で有利発行に当たらないと判断しており、第三者割当増資に係る取締役会に出席した当社の監査役 4 名(うち社外監査役 3 名)全員が、上記指針に準拠するものであり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

第2次第三者割当増資により、本割当予定先に対して割り当てる当社普通株式の数量11,868,000株は、平成25年6月6日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,176,623,887株から第1次第三者割当増資によりQualcommに対して発行した当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して発行した当社普通株式の数量35,804,000株を除いた1,110,699,887株に対して1.07%（議決権総数1,094,934(注)個に対する割合1.08%）となります。また、第2次第三者割当増資と同じく共同開発・出資契約に基づく第1次第三者割当増資において本割当予定先に対して割り当てた当社普通株式30,120,000株との合計数は41,988,000株となり、平成25年6月6日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,176,623,887株から第1次第三者割当増資によりQualcommに対して発行した当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して発行した当社普通株式の数量35,804,000株を除いた1,110,699,887株に対して3.78%（議決権総数1,094,934個(注)に対する割合3.83%）となります。

しかしながら、前記「2. 募集の目的及び理由」及び「3. (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおり、第2次第三者割当増資により調達する資金は、当社の優位性及び成長性を確保する上で重要となるモバイル機器向けの次世代MEMSディスプレイの共同開発に係る投資等に充当することで、当社グループの中長期的な収益力向上及び競争力強化に資するものであり、ひいては中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与するものであることから、第2次第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

なお、第2次第三者割当増資により本割当予定先に対して割り当てる予定の当社普通株式の数量11,868,000株、第1次第三者割当増資によりQualcommに割り当てた当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して割り当てた当社普通株式の数量35,804,000株の総数77,792,000株は、平成25年6月6日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,176,623,887株から第1次第三者割当増資によりQualcommに対して発行した当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して発行した当社普通株式の数量35,804,000株を除いた1,110,699,887株に対して7.00%（議決権総数1,094,934個(注)に対する割合7.10%）となっております。

(注) 議決権総数は発行済株式総数1,176,623,887株から、平成25年3月31日時点の株主名簿に基づく単元未満株式5,291,887株、自己保有株式（単元未満株式を除く）10,399,000株及び相互保有株式75,000株並びに第1次第三者割当増資によりQualcommに対して発行した当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して発行した当社普通株式の数量35,804,000株を控除して算出したものです。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

①	名 称	Qualcomm Incorporated		
②	所 在 地	アメリカ合衆国 カリフォルニア州 92121 サンディエゴ モアハウス・ドライブ 5775 (5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.)		
③	代表者の役職・氏名	Chairman of the Board and Chief Executive Officer Paul E. Jacobs		
④	事 業 内 容	CDMA (符号分割多重接続) 技術を使う各種の移動通信システムや端末向けのベースバンド・チップセットの開発・販売、及びCDMAに係るライセンスの供与等		
⑤	資 本 金	172,600 US ドル (2013年3月31日現在) (なお、払込資本は12,991百万USドル)		
⑥	設 立 年 月 日	1985年7月1日		
⑦	発 行 済 株 式 数	1,727,835,431 株 (2013年4月22日現在)		
⑧	決 算 期	9月 (同月最終日曜日)		
⑨	従 業 員 数	約26,600名 (2012年9月30日現在)		
⑩	主 要 取 引 銀 行	Bank of America Corporation		
⑪	主 要 取 引 先	Samsung Electronics Co. Ltd. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.		
⑫	大株主及び持株比率	BlackRock Advisors, LLC	6.12%	
		The Vanguard Group, Inc.	4.35%	
		State Street Global Advisors (SSgA)	4.00%	
		Fidelity Management & Research Company	3.41%	
		T. Rowe Price Associates, Inc.	2.77%	
⑬	当事会社間の関係			
	資 本 関 係	当該会社は当社の普通株式30,120,000株 (平成25年3月31日現在の発行済株式総数1,176,623,887株に対する割合は2.56%) を保有しております。当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	当社は、割当予定先との間で、携帯電話 (スマートフォン) 用チップセットの購買等に関する取引関係があります。		
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭	最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期		2010年9月期	2011年9月期	2012年9月期
連 結 純 資 産		20,858百万USドル (1,737,889百万円)	26,972百万USドル (2,068,752百万円)	33,545百万USドル (2,602,253百万円)
連 結 総 資 産		30,572百万USドル (2,547,259百万円)	36,422百万USドル (2,793,567百万円)	43,012百万USドル (3,336,656百万円)
1株当たり連結当期純資産		12.70 USドル (1,058円)	16.27 USドル (1,248円)	19.73 USドル (1,531円)
連 結 売 上 高		10,982百万USドル (915,020百万円)	14,957百万USドル (1,147,202百万円)	19,121百万USドル (1,483,312百万円)
連 結 営 業 利 益		3,727百万USドル (310,534百万円)	5,026百万USドル (385,494百万円)	5,682百万USドル (440,781百万円)
連 結 当 期 純 利 益		3,247百万USドル (270,540百万円)	4,260百万USドル (326,742百万円)	6,109百万USドル (473,906百万円)
1株当たり連結当期純利益		1.98 USドル (165円)	2.57 USドル (197円)	3.59 USドル (278円)
1株当たり配当金		0.72 USドル (60円)	0.81 USドル (62円)	0.93 USドル (72円)

- (注) 1. 上記の円表記は、1 US ドルを、2010 年 9 月期は、平成 22 年 (2010 年) 9 月 30 日の東京外国為替市場終値 83.32 円、2011 年 9 月期は、平成 23 年 (2011 年) 9 月 30 日の東京外国為替市場終値 76.70 円、2012 年 9 月期は、平成 24 年 (2012 年) 9 月 28 日の東京外国為替市場終値 77.575 円にて換算しております。
2. 本割当予定先である Qualcomm は、米国 NASDAQ 証券取引所に上場しております。米国では、反社会的行為を規制する The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act が存在し、Qualcomm は米国 NASDAQ 証券取引所上場企業として同規則によりこうした法令の遵守の徹底を求められていること、また、当社は、割当予定先である Qualcomm から、同社の知る限り、同社の役員及び主要株主が暴力団等とは一切関係がない旨の表明を取得しております。これらのことにより、当社は、本割当予定先が暴力団等とは一切関係がないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に提出しております。
3. 平成 24 年 12 月 4 日プレスリリースでご報告したとおり、Qualcomm の 100%出資子会社である Pixtronix と次世代 MEMS ディスプレイの共同開発を目的とする共同開発契約を締結しております。

## (2) 割当予定先を選定した理由

前記「2. 募集の目的及び理由」をご参照ください。

## (3) 割当予定先の保有方針

本割当予定先である Qualcomm とは出資契約を締結しており、同契約において下記のとおり譲渡制限に同意しており、第 2 次第三者割当増資により割り当てる当社普通株式の保有方針について、当社の安定株主及び次世代 MEMS ディスプレイの共同研究に係る事業パートナーとして継続的に保有する方針であることを確認しています。

また、共同開発・出資契約において、本割当予定先である Qualcomm は、第 1 次第三者割当増資が実施された日及び第 2 次第三者割当増資が実施された日からそれぞれ 1 年間は、当社の事前の書面による承諾がある場合及び当社による共同開発・出資契約等に関する重大な契約違反がある場合を除き、それぞれの第三者割当増資により割り当てる当社普通株式の全部又は一部を第三者に譲渡しないことに合意しております。

また、本割当予定先である Qualcomm は、共同開発・出資契約において、第 1 次第三者割当増資及び第 2 次第三者割当増資のそれぞれの払込日から 1 年経過した日以降 2 年間までの間に、その保有する当社の株式を、取引市場で売却する場合には一定の売却数量制限に服するものとし、また、取引市場外で第三者に譲渡しようとする場合には、当社に対して 30 日前に通知を行い、当社と売却先及び売却条件について協議し、当社が所定の条件を充たす売却先を指定した場合には当該売却先に売却することについて合意しております。

なお、当社は、本割当予定先である Qualcomm より、第 2 次第三者割当増資の割当日から 2 年以内に当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に報告すること、並びに当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。なお、第 1 次第三者割当増資に係る確約書はすでに取得済みです。

## (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社としては、本割当予定先である Qualcomm から開示された Qualcomm の直近(2013 年 9 月期第 2 四半期)を含む財務諸表を確認しております。これらによれば、Qualcomm の 2013 年 3 月 31 日付の連結財務諸表においては、総資産 47,599 百万 US ドル、純資産 37,628 百万 US ドル並びに現金・預金及び現金同等物 4,093 百万 US ドルとなっております。これらにより Qualcomm が十分な資金力を有していることが確認できることから、第 2 次第三者割当増資の払込みについて問題はないと判断しております。

## 7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 25 年 3 月 31 日現在）		募集後	
日本生命保険相互会社	4.73%	日本生命保険相互会社	4.68%
明治安田生命保険相互会社	3.89%	明治安田生命保険相互会社	3.85%
株式会社みずほコーポレート銀行	3.56%	Qualcomm Incorporated	3.53%
株式会社三菱東京UFJ銀行	3.54%	株式会社みずほコーポレート銀行	3.53%
サムスン電子ジャパン株式会社	3.04%	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.51%
三井住友海上火災保険株式会社	2.61%	サムスン電子ジャパン株式会社	3.01%
Qualcomm Incorporated	2.56%	三井住友海上火災保険株式会社	2.58%
シャープ従業員持株会	2.19%	シャープ従業員持株会	2.17%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1.94%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1.92%
株式会社損害保険ジャパン	1.83%	株式会社損害保険ジャパン	1.81%

(注) 募集後の持株比率については、平成 25 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として、第 2 次第三者割当増資による異動を反映しております。

## 8. 今後の見通し

第 2 次第三者割当増資に伴う業績への影響につきましては、平成 25 年 5 月 14 日に公表いたしました平成 26 年 3 月期通期連結業績予想に織り込み済みです。

なお、第 2 次第三者割当増資に関し今後開示すべき事実が生じましたら、速やかに開示いたします。

## 9. 企業行動規範上の手続に関する事項

第 2 次第三者割当増資は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条、株式会社大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第 2 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

## 10. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近 3 年間の業績（連結）

	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
売上高	3,021,973 百万円	2,455,850 百万円	2,478,586 百万円
営業利益又は営業損失(△)	78,896 百万円	△37,552 百万円	△146,266 百万円
経常利益又は経常損失(△)	59,124 百万円	△65,437 百万円	△206,488 百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	19,401 百万円	△376,076 百万円	△545,347 百万円
1 株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	17.63 円	△341.78 円	△489.83 円
1 株当たり配当金	17.00 円	10.00 円	0.00 円
1 株当たり純資産	932.46 円	568.83 円	106.90 円



(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25 年 6 月 6 日現在）

	株 式 数	発行済普通株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	1, 176, 623, 887 株	100. 0%
現時点の転換価額（行使価額）に おける 潜 在 株 式 数	79, 272, 662 株	6. 7%
下限値の転換価額（行使価額）に おける 潜 在 株 式 数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）に おける 潜 在 株 式 数	—	—

(3) 最近の株価の状況

① 最近 3 年間の状況

	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
始 値	1, 172 円	824 円	606 円
高 値	1, 260 円	842 円	607 円
安 値	626 円	467 円	142 円
終 値	825 円	604 円	272 円

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部による。

② 最近 6 か月間の状況

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
始 値	310 円	326 円	295 円	271 円	325 円	452 円
高 値	352 円	357 円	356 円	403 円	633 円	462 円
安 値	281 円	286 円	260 円	234 円	318 円	395 円
終 値	311 円	294 円	272 円	338 円	476 円	401 円

(注) 1. 株価は東京証券取引所市場第一部による。

2. 平成 25 年 6 月の株価については、平成 25 年 6 月 6 日現在で表示しております。

③ 発行決議日前取引日における株価

	平成 25 年 6 月 6 日
始 値	405 円
高 値	423 円
安 値	395 円
終 値	401 円

(4) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

第 1 次第三者割当増資（払込期日：平成 24 年 12 月 27 日）及び平成 25 年 3 月 6 日決議第三者割当増資（払込期日：平成 25 年 3 月 28 日）については、払込みを完了しております。

各第三者割当増資公表時の募集内容等は以下のとおりであります。

<第 1 次第三者割当増資>

払 込 期 日	平成 24 年 12 月 27 日
調 達 資 金 の 額	4, 711, 680, 000 円（差引手取概算額）
発 行 価 額	1 株につき 164 円
募集時における発行済株式総数	1, 110, 699, 887 株
当該募集による発行株式数	30, 120, 000 株
募集後における発行済株式総数	1, 140, 819, 887 株
割 当 先	Qualcomm Incorporated 30, 120, 000 株
発行時における当初の資金使途	次世代 MEMS ディスプレイの開発経費及び開発用設備投資
発行時における支出予定時期	平成 24 年 12 月～平成 25 年 3 月
現時点における充当状況	当初の資金使途に従い充当しております。

<平成25年3月6日決議第三者割当増資>

払 込 期 日	平成25年3月28日
調 達 資 金 の 額	10,134,160,000円 (差引手取概算額)
発 行 価 額	1株につき290円
募集時における発行済株式総数	1,140,819,887株
当該募集による発行株式数	35,804,000株
募集後における発行済株式総数	1,176,623,887株
割 当 先	サムスン電子ジャパン株式会社 35,804,000株
発行時における当初の資金使途	液晶ディスプレイの高精細化のための新規技術導入、タブレット端末や高精細ノートパソコンといったモバイル機器関連の液晶製造設備の合理化等に係る投資等
発行時における支出予定時期	平成25年4月～平成27年3月
現時点における充当状況	当初の資金使途に従い一部充当しております。

1.1. 発行要項

- |   |   |
|---|---|
| (1) 募 集 株 式 の 数   | 11,868,000株   |
| (2) 払 込 金 額   | 1株につき502円   |
| (3) 払 込 金 額 の 総 額                                       | 5,957,736,000円  |
| (4) 増 加 する 資 本 金 の 額                                    | 2,978,868,000円  |
| (5) 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額                                | 2,978,868,000円  |
| (6) 募 集 又 は 割 当 方 法<br>( 割 当 予 定 先 及 び<br>割 当 予 定 株 数 ) | 第三者割当の方法による。<br>(Qualcomm Incorporated 11,868,000株)   |
| (7) 払 込 期 日   | 平成25年6月24日(月)   |
| (8) そ の 他   | ※金融商品取引法に基づく第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書及び本訂正届出書の効力発生を条件とします。 |

以 上